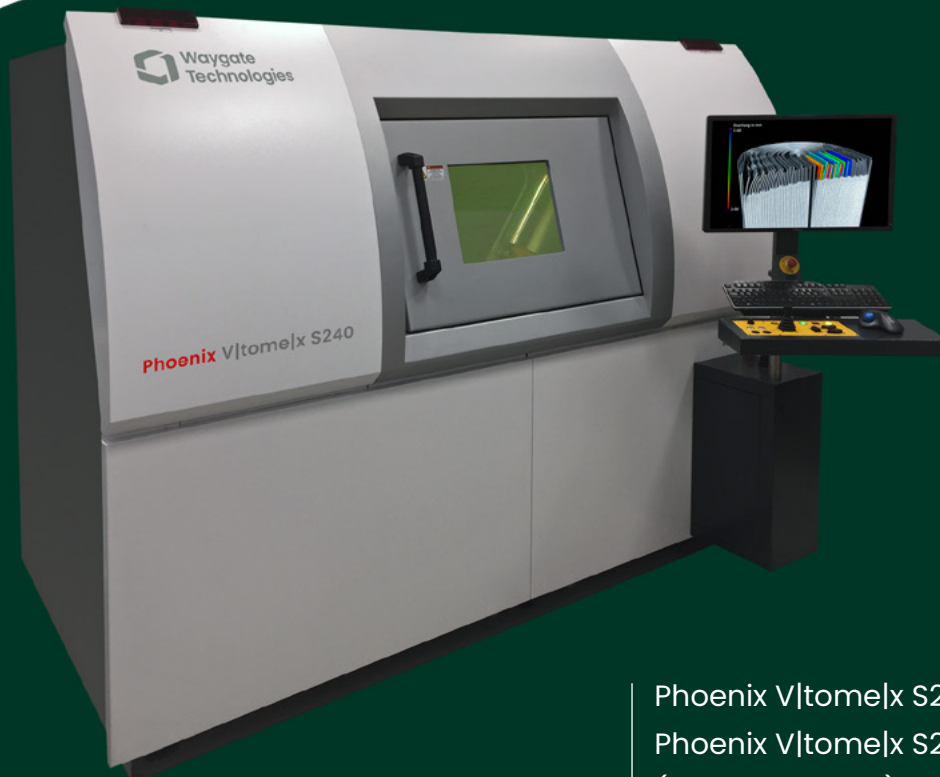


Phoenix V|tome|x S240 마이크로CT

다목적 산업용 2D 방사선 촬영 및 향상된 기능 및 디자인이 적용된 고해상도 검사를 위한 3D CT 시스템.



Phoenix V|tome|x S240
Phoenix V|tome|x S240 듀얼튜브
(+180kV 나노CT®)

정확하고 효율적인 검사.

베스트셀러 산업용 CT 기기

2003년 출시 당시 Phoenix Vtome|x S는 최초의 실험실 크기의 매우 견고한 마이크로CT 및 나노CT® 시스템이었습니다. 독특한 듀얼튜브 구성 옵션을 통해 전 세계의 연구 기관 및 품질 연구소에 약 500 개의 설치를 통해 전 세계적으로 가장 잘 팔리는 CT 시스템이 되었습니다.

유형을 선도하는 해당 시스템의 새로운 세대가 출시되어, 고객은 고해상도, 사용의 편리성 및 뛰어난 가성비율을 결합한 2D 검사 및 3D CT 시스템의 전례없는 다목적성의 이점을 경험할 수 있었습니다.

새로운 Phoenix Vtome|x S240 마이크로CT 시스템은 다음과 같은 다양한 용도로 사용가능합니다.



내부 결함 분석



3D 정량 투과성 분석



융통성 있는
2D X-ray 검사



자재 구조 분석



조립 제어

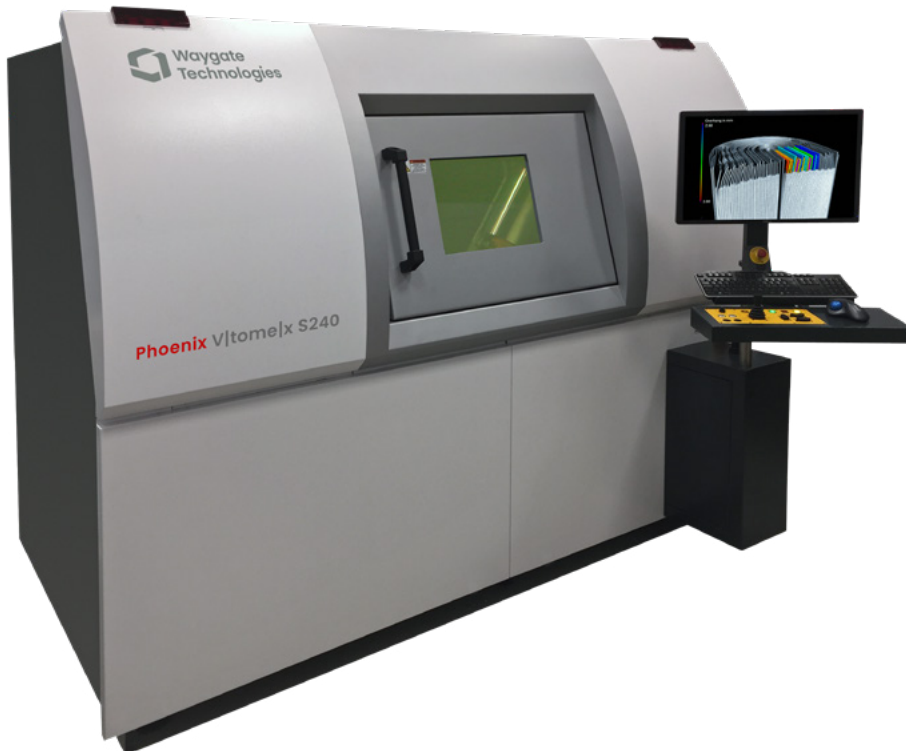


CAD 데이터 일반/실제
(nom/act) 비교

더 빠른 속도로 스캔하고 더 많이 확인하십시오.

Phoenix V|tome|x S240은 매우 효율적인 Dynamic 41 디텍터기술 및 High-flux|target을 결합한 전 세계에 몇 가지 CT 시스템 중 하나로 고품질 이미지를 위해 더 빠른 속도로 스캔하거나 향상된 정확도로 스캔하고 매우 혁신적인 검사를 합니다.

당사는 여러 형태 및 추가적인 도구를 제공하여 귀하가 높은 정확도로 생산 처리량 목표를 달성하도록 지원합니다. High-flux|target 및 멀티 빔 경화 교정 기능을 통해 향상된 품질의 이미지를 얻고, 효율성과 편리성을 통해 검출 가능성(POD)을 향상시킬 수 있습니다.



● Dual|tube

마이크로 및 나노포커스 X-Ray 튜브 간 빠르고 편리한 변환.

● Dynamic 41 디지털 디텍터

하이 다이내믹 대형 16인치 디지털 평면 디텍터.

● DXR S100 Pro 디텍터

고해상도 검사를 위한 100 μ m 픽셀 피치(pitch) 디텍터(옵션).

● High-flux|target

더 빠른 속도의 마이크로CT 스캔을 통한 효율성 향상 또는 더 작은 초점에 높은 전력을 사용해 가능한 두 배의 해상도.

● Helix|CT

향상된 품질의 이미지로 스캔하여 효율성과 편리성을 통해 검출 가능성(POD)을 향상하십시오.

● Offset|CT

최대 100% 더 커진 스캔용 공간을 통해 더욱 큰 부품을 스캔하십시오.

● 빔 경화 교정 기능

Multi|bhc 도구는 불량 인공음영을 교정합니다. 주로 여러 소재 샘플 내 밀도가 높은 부분 사이에 위치하는 여러 개의 어두운 색의 불량 띠부분으로 나타납니다.

● Phoenix Datas|x CT 소프트웨어

데이터 수집, 부피 공정, 그리고 평가 공정을 편리하게 완전 자동화하십시오.

● 전체 2D 검사

매우 융통성 있는 방사선 촬영 검사를 위해 기울어진 축($\pm 45^\circ$)을 조정하십시오.

● Flash! 이미지 최적화

2D 전자장치 및 주조검사 최적화된 고성능 차세대 결합 감지 기능.

특정 검사를 위한 마이크로 및 나노CT® 솔루션.

속도, 검출 상세사항, 또는 두 가지 모두를 향상시켜야 할 때, Phoenix V|tome|x S240은 모든 3D 산업 또는 과학 관련 마이크로CT 검사에 맞도록 구성할 수 있습니다. 높은 융통성을 위해, V|tome|x S240은 추가적으로 180kV/20W 고성능 나노포커스 X-ray 튜브 및 240kV/320W 마이크로포커스 X-ray 튜브가 장착될 수 있습니다. 이 독특한 조합 덕분에, 해당 시스템은 다양한 용도를 위해 이상적인 도구입니다. 흡수성이 낮은 소재의 초고해상도 스캔뿐만 아니라 최대 500mm 지름의 흡수성이 높은 물체의 3D 분석에 사용 가능합니다.

산업용 3D NDT

R&D 분야의 고해상도 3D 분석 및 실험실의 분석 실패를 극복하고, 이 기기는 사출 성형, 작은 주물, 전자 기기, 센서, 배터리, 복잡한 합성물 그리고 3D 프린팅 부품을 3D 제조방식을 통해 제어할 수 있도록 지원합니다. 그리고 Offset|CT를 사용하여, 최대 100% 더 커진 스캔용 공간을 통해 더욱 큰 부품을 스캔할 수 있습니다.

- 내부 결함 분석 / 3D 정량 투과성 분석
- 조립 제어
- 자재 구조 분석

R&D

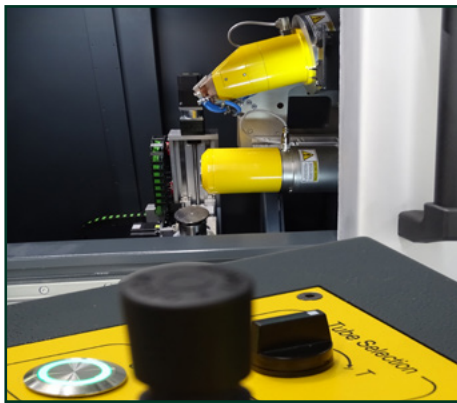
고해상도 180kV 나노CT®를 통해, Phoenix V|tome|x S240은 초미세 규모까지 연구 및 개발을 하기 위한 비파괴 3차원 방식을 선보입니다. 준비, 슬라이싱, 코팅 또는 진공 처리가 필요하지 않습니다.

용통성, 정확성 그리고 편리성을 위한 향상된 도구.

Waygate Technologies는 여러 옵션을 제공하여 CT 스캔의 품질 및 생산성을 향상시킵니다.

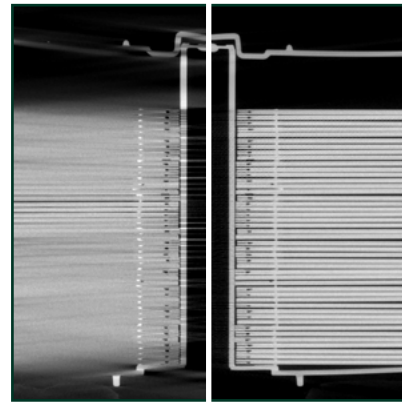
듀얼튜브 CT

특히 연구 및 전자제품 검사를 위한 용도 범위를 확장하기 위해, V|tome|x S240은 추가적으로 180kV 고성능 나노포커스 X-ray 튜브가 장착될 수 있습니다. 나노CT®는 가장 상세한 수준인 200 나노미터의 검출이 가능합니다. 몇 분 내에, 해당 튜브는 버튼을 전환하면 자동으로 변경됩니다.



Helix|CT

Phoenix V|tome|x S240은 나선형(또는 선형) 스캔을 수행할 수 있고, 샘플이 지속적으로 위쪽의 X-ray 빔을 향해 이동합니다. 이를 통해 더욱 긴 부품을 더 빠른 속도로 스캔할 수 있고, 여러 개로 나뉜 스캔 결과를 나중에 한꺼번에 연결할 필요가 없습니다. 한편, 이 수집 기술은 수평의 표면 및 연결 부분에 인공제품을 제거하여 더 중요한 검사결과를 도출합니다.

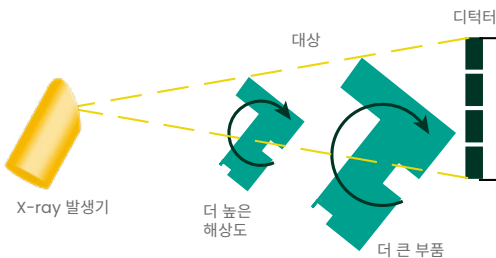


기존의

Helix|CT

Offset|CT

Offset|CT 스캔 성능을 통해, V|tome|x S240과 같은 소형 CT 시스템은 전례없이 더 큰 부품을 스캔할 수 있거나, 동일한 크기의 부품을 더 높은 해상도로 스캔할 수 있습니다.



클릭 및 측정|CT

전체 CT 공정 체인은 하나의 버튼을 눌러 완전히 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 사용자의 시간과 영향력을 줄이고, 생산성 및 CT 결과의 재현성을 급격히 향상시킵니다.

통찰력을 통한 측정

조직적인 측정 기반의 비파괴 CT

3D CT는 기존의 촉각 또는 시각의 조직적인 측정 기기(CMM)의 한계점을 극복하고 많은 이점을 제공합니다. 특히 보이지 않거나 관리가 어려운 표면의 복잡한 부품의 경우에 많은 이점을 제공합니다.

- 명칭 및 실제 CAD 비교
- 차원 측정/벽 두께 분석
- 1차 대상물 검사
- 도구 변상
- 뒤집힌 기술/도구 변상



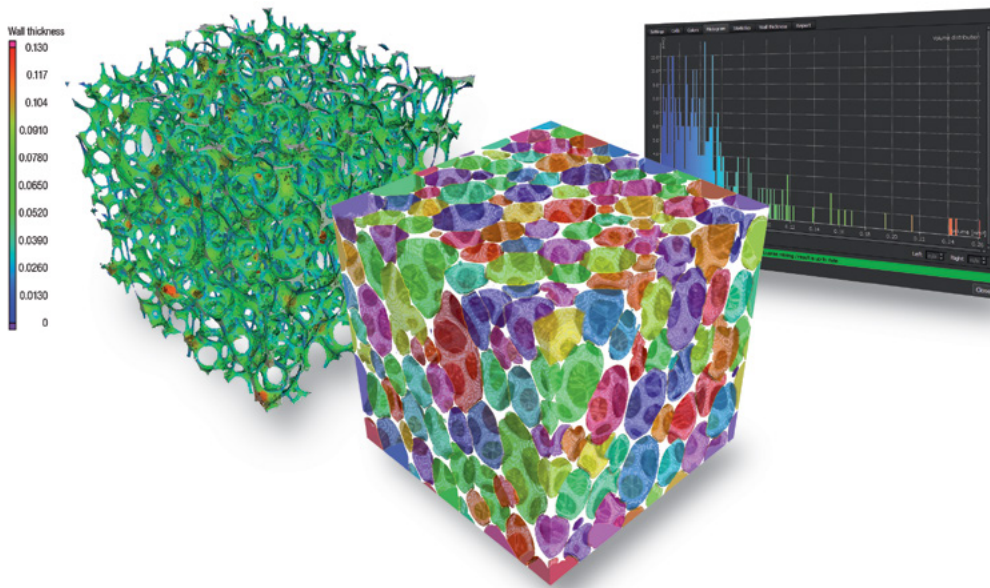
일반 사양

Phoenix V tome x S240	
X-ray 튜브형	개방 지향성 고성능 마이크로포커스 X-ray 튜브, 폐쇄 냉각수 회로. 추가적인 (개방) 전송 고성능 나노포커스 X-ray 튜브
최대 전압 / 전력	240kV/320W 나노CT*용 듀얼 튜브 옵션: 추가적인 180kV/20W 고성능 나노포커스 튜브 및 다이아몬드윈도우, 그리고 하나의 버튼을 한번 눌러 공기 베어링 및 편리한 튜브 교환이 가능한 정확한 회전 유닛
기하학적 확대(3D)	1.39 x ~ 100 x; 나노포커스 튜브를 통해 최대 400 x
상세한 검출력	< 1µm(마이크로포커스 튜브)까지 단축, 추가적으로 최소 0.2µm(나노포커스 튜브)까지 단축
최소 복셀 크기	2µm(마이크로포커스 튜브)까지 단축 추가적으로 최소 1µm(마이크로포커스 튜브)까지 단축
디텍터 유형 (모두 US ASTM E2597 표준에 따름)	탁월한 이미지 및 결과 품질을 제공하는 온도 안정화 Dynamic 4 200p+ 대면적 디텍터, 410 x 410mm (16" x 16"), 200µm 화소 크기, 2036 x 2036 화소(4MP), 초고 명암비 > 10000:1 추가적인 온도는 디지털 DXR 디텍터 배열, 200µm 픽셀 크기, 1,000 x 1,000픽셀, 200 x 200mm(8"), 2 x 실제 디텍터 확장을 안정화 함 옵션인 DXR S100 Pro 디텍터, 100µm 픽셀 크기, 뛰어난 해상도 이미지를 위한 2,500 x 3,000 픽셀 및 300mm x 250mm의 넓은 활성 영역에서 뛰어난 탐지 가능성 - 1.3배 가상 디텍터 확대 옵션
조작법	5개 축의 금속 정확도 조정기, 높은 기계적 안정성을 위한 최적화된 구성
초점 - 디텍터 - 거리	800mm(8" 디텍터 + IMR) 및 940mm(16" 디텍터)
최대 샘플 지름 x 높이	최대 3D 스캔 크기 최대 425mm Ø x 360mm 및 추가적인 Offset CT(16"), 최대 500mm Ø x 275mm 및 최적화 Offset CT(8") 디텍터
최대 샘플 중량	10kg(22lbs.)
최대 초점 촬영 거리	580mm(마이크로포커스 튜브)
시스템 크기(W x H x D)	2,550mm x 1,905mm x 1,275mm(100,4" x 75" x 50,2")
시스템 중량	약 4,050kg/8,990lbs. (외부 부품 제외)
온도 안정	활성 X-ray 튜브 냉각 및 온도 안정화 디텍터
추가적인 High-flux target	CT 스캔보다 2배 빠른 속도 또는 2배의 해상도, X-ray 검사 전력 최대 100W
최적화 2D 검사 번들	최대 10kg(22lbs.) 샘플의 기울어진 2D 검사를 위한 기울어진 회전 축 그리고 Flash Filters™을 통한 2D 검사 소프트웨어
최적화 측정 편집(업그레이드 옵션 포함)	Phoenix Datas x CT 소프트웨어 패키지 "측정" 2개의 교정 대상
최적화 Helix CT 및 Offset CT	향상된 스캔 용적 및 데이터 품질을 위한 향상된 스캔 계획: 길이가 긴 부품을 더 적은 가공과 더 높은 품질로 스캔하기 위한 Helix CT, 더 큰 부품이나 동일한 크기의 부품을 더 높은 해상도로 스캔하기 위한 Offset CT
최적화 클릭 및 측정 CT	선택적인 완전 자동화된 CT 공정망
소프트웨어	Phoenix Datas x 3D 계산형 단층 촬영 및 복원 소프트웨어. 3D 계량, 실패 또는 요청된 구조 분석을 위한 여러 3D 평가 소프트웨어 패키지
방사선 방호	독일 StrSchG/StrSchV에 따라 형식 승인 없이 전체 보호 설치 방사선 안전 캐비닛. 프랑스 NFC 74 100 및 미국 성능 표준 21 CFR Subchapter J.를 준수하며 작동의 경우 기타 공식 라이선스가 필요할 수 있습니다

Phoenix V|tome|x S240

향상된 성능을 위한 협업.

다용도 Phoenix V|tome|x S240의 탁월한 가격/성능 비율은 Waygate Technologies가 과학적 연구, 산업용 품질 보장, 그리고 제조 공정을 더욱 효율적으로 지원하는 방법의 한 예시일 뿐입니다. 전체적인 정확도 CT 라인, 다양한 추가적인 혁신, 그리고 전문 서비스를 지원하며, 당사는 전 세계적인 서비스 네트워크를 통해 귀하의 작업을 위한 정확도 및 생산성 향상에 헌신합니다.



WaygateTechnologies

Niels-Bohr-Str. 7
31515 Wunstorf
Germany
전화: +49 5031 172 100
팩스: +49 5031 172 299
이메일: phoenix-info@bakerhughes.com

Waygate Technologies USA, LP

11988 Tramway Dr
Cincinnati, OH 45241
USA
전화: 1 844 991 0474

보다 자세한 정보 또는 데모를 요청하려면 당사의 웹사이트를 방문하거나 다음으로 연락주시기 바랍니다.

waygate-tech.com